

2026年度 製造中核人材育成セミナー日程

	1日目	(プロセス)		2日目	(プロセス)		3日目	(プロセス)		4日目	(プロセス)
9:00			9	プロセス講義	38.n-ch S/Dインブラ 39. フォトレジスト除去	9	実習生プロセス ・ フォトリソ (3回目)	46.コンタクトフォトリソ	9	プロセス講義	50.AIフォトリソ
				実習生プロセス ・ フォトリソ (2回目)	40. p-ch S/Dフォトリソ		休憩			測定講義	
10:00			10	休憩		10	実習生プロセス ・ エッチング (Si-RIE) ・ フォトレジスト除去	47. 酸化膜エッチング 48. フォトレジスト除去 49. AI堆積	10	休憩	
	開始 10:30 御挨拶			実習生プロセス ・ イオン注入	41. p-ch S/Dインブラ		休憩			実習生プロセス ・ 配線フォトリソ	51. AIエッチング
	11:00 オリエンテーション		11	休憩	42. フォトレジスト除去	11	実習生プロセス ・ スパッタリング		11	実習生プロセス ・ AIエッチング (Metal-RIE) ・ レジスト除去 (WET) ・ AISンタリング	52. フォトレジスト除去 53. シンタリング
	安全講習			周辺装置実習 ・ マスクレス露光装置実習			CRユーティリティ見学	49. 逆スパッタ 49. AI堆積		実習まとめ 集合写真撮影	
12:00	クリーンルーム入室・見学	予備時間	12	昼食 Lunch	43. RCA洗浄	12	昼食 Lunch		12	昼食 Lunch	予備時間
	昼食 Lunch		13	実習生プロセス ・ RCA洗浄 ・ 拡散炉	44. S/D活性化熱処理 45. 酸化膜堆積	13	プロセス講義 休憩	予備時間	13	周辺装置実習 ・ ダイサー ・ ダイボンディング ・ ワイヤーボンディング	
13:00	プロセス講義		14	休憩		14	周辺装置実習 ・ CMPプロセス解説 ・ CMP実習		14	測定実習 ・ nMOS、pMOS静特性 ・ インバータ静特性 ・ リングオシレータ測定	
14:00			15	実習生プロセス ・ PE-CVD ・ 膜厚測定		15	周辺装置実習 ・ FIB-SEM ・ CMOSチップのSEM観察	予備時間	15	まとめ 修了証授与 終了16:00	
	実習生プロセス ・ フォトリソ (1回目)	34. ゲートフォトリソ		休憩			休憩				
	休憩		16	回路・レイアウト設計演習	予備時間	16	館内・館外ユーティリティ見学				
16:00	実習生プロセス ・ エッチング (Metal-RIE) ・ フォトレジスト除去 (PR)	35. Poly-Siエッチング 36. フォトレジスト除去					マイクロ化機器利用紹介	予備時間			
17:00	交流会 Q&A (自由参加)	37. n-ch S/Dフォトリソ	17	Q&A (自由参加)		17	Q&A (自由参加)				

座学・演習 (AV講義室)

CMOSプロセス実習 (CR)

周辺装置実習・見学

昼食・休憩